

## TEZKOM BMC 108300 LP

Elektrik uygulamaları, beyaz eşya, fonksiyonel malzemeler için low profile BMC hamur kalıplama bileşimi.

- Low Profile Ürün.
- Hacimsel çekmesi sıfıra yakın.
- Sadece açık renklerde üretilebilir.
- Halojenli kimyasal veya asbest içermez.
- Sıcak presleme prosesine uygundur. Kromlanmış kalıplar ile kullanılırsa yüzey parlaklığı ve yüzey homojenitesi artırılabilir.
- Yüzey parlaklığı kalıp yüzeyi ile birebir ilişkilidir.

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

	STANDART	BİRİM	DEĞER
YOĞUNLUK	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	1.9
% HACİMSEL ÇEKME	ISO 2577	%	0.00
% SONRADAN ÇEKME	ISO 2577	%	0.0
EĞİLME E-MODÜLÜ	ASTM D790	GPa	11
EĞİLME MUKAVEMETİ	ASTM D790	MPa	120
%KIRILMA	ASTM D790	%	0.4
DARBE DİRENCİ	ISO 179	kJ/m <sup>2</sup>	35
BARKOL SERTLİĞİ	ASTM D 2583	Barkol	65
ALEV İLERLETME	UL 94		HB
YÜZEY GERİLİMİ	IEC 60093	Ohm	10 <sup>12</sup>
SU ABSORBSİYONU	ISO 62	%	<0.5
KALIPTA YÜRÜME	TEZKOM TT0012		12
ÖNERİLEN PRESLEME SICAKLIĞI		°C	130-150
ÖNERİLEN PRESLEME BASINCI		Bar	40-80

### AMBALAJLAMA

BMC 108300, stiren geçirmeyen torbalar içine paketlenir ve karton kutular ile sevk edilir. Çeşitli ambalaj çeşitleri mevcuttur. Alternatif ambalajlar için lütfen teknik servis ekibimize iletişime geçin.

Bu bilgiler genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bilgi yetersizliği nedeni ile oluşacak sorunlardan TEZKOM A.Ş. sorumlu değildir.